銘傳大学　電気工学研究科

銘傳大学 日本人向け修士課程　×　日月光グループ（ASE）

国際半導体人材育成修士プログラム

世界を牽引する台湾の半導体産業で、
あなたの未来を切り拓く。

日本人学生向け　・　2027年2月入学



WHY THIS PROGRAM

本プログラムが選ばれる３つの理由

01

学費実質無料と手厚い生活支援

教育部の補助により学費は２年間とも実質無料。さらに在学中は毎月の生活手当も支給され、安心して学業に専念できます。

02

半導体に特化した２年間の専門教育

２年間を通じて、半導体の専門知識を基礎から応用まで、体系的に習得します。台湾華語も継続して学べます。

03

卒業後のキャリアの選択肢

修了後は半導体エンジニアへ。一定の条件を満たした学生には、連携企業ASEでの就労という選択肢も広がります。

連携企業

ASE

Advanced Semiconductor Engineering, Inc.
（日月光グループ）

世界有数の半導体製造企業

世界を牽引するリーダー企業

半導体の組み立ておよび検査分野における世界トップクラスのシェアと技術力を誇るグローバル企業です。

持続可能な次世代のモノづくり

スマート製造と環境配慮型経済（グリーンエコノミー）を推進し、持続可能なサプライチェーンを構築しています。

卒業後のキャリア先の一つ

一定の条件を満たした修了生には、ASEでの就労という選択肢も。世界最高峰の技術の現場でキャリアを築けます。

CURRICULUM & STEPS

修了までのカリキュラムとステップ

STEP 1

１年次　前期・後期

大学での専門教育

- 基礎から応用までの理論習得
- 半導体デバイス・製造プロセス
- 基礎華語（週６時間）などを履修

STEP 2

２年次　専門の深化

修士課程を継続履修

- 半導体の専門知識（専門選択科目）を深く履修
- 台湾華語の科目を継続して学習
- 指導教員のもとで修士論文を執筆

STEP 3

卒業・修士号取得

プロのエンジニアへ

- 台湾・銘傳大学の修士学位を取得
- 世界レベルの技術者として
- キャリアをスタート

修了要件　合計36単位（専門必修６単位 ＋ 専門選択30単位）＋ 修士論文

LANGUAGE & SUPPORT

語学要件と手厚いサポート体制

入学前の要件

英語

専門授業を理解できる基礎力

英語による専門授業を理解できる基礎力（CEFRレベル B1 程度）があればスタート可能です。

CEFR B1

１年次のサポート

基礎華語

大学が手厚くサポート

大学が毎週 6 時間の「基礎・台湾華語」の授業を提供。台湾での生活と学習を、入学当初から支援します。

週 6 時間

２年次の目標

台湾華語

学習を継続して到達

２年次も華語科目を継続履修しながら、さらに半導体の知識を掘り下げて習得します。

基礎級

FINANCIAL SUPPORT

学費補助と生活支援

学費

１年目・２年目とも

実質無料

条件（指定の語学要件）を満たせば、教育部の補助により実質無料となります。

＊学期初めに全額を立替納付後、大学を通じて補助を申請します。

生活手当

１年目・２年目とも

10,000 新台湾ドル / 月

在学中は毎月の生活手当を支給。経済的な不安なく、学業に専念できる環境を整えます。

＊支給には所定の要件があります。

COSTS & LIVING

各学期の固定費用と住環境の目安

学費

54,752

新台湾ドル

＊条件を満たせば全額補助の対象。実質的な負担はありません。

保険料

4,956

新台湾ドル（半年分）

学期ごとに必要となる保険料の目安です。

学生寮費

16,000

新台湾ドル

＊学外での賃貸マンション契約も自由に選択可能です。

外国人学生の住居費・生活費は原則自己負担ですが、台湾は物価が安定しており暮らしやすい環境です。在学中は毎月支給される生活手当も活用できます。

WHAT YOU STUDY

2年間で学ぶ半導体専門教育

半導体デバイス・製造プロセス

基礎から応用まで、半導体の中核技術を理論的に習得します。

専門選択科目

半導体に関する幅広い専門分野を、2年間でより深く履修します。

台湾華語

1年次の基礎華語（週6時間）から2年次まで継続して学習します。

修士研究・論文

指導教員のもとで研究を遂行し、修士論文を執筆します。

日本人学生 約15名の受け入れを予定しています。少人数で、一人ひとりに目の届く学習環境のなか、2年間じっくりと専門性を高めます。

CAREER PATH

卒業後のキャリアパス



キャリアの選択肢の一つ

一定の条件を満たした修了生には、連携企業ASEグループでの就労という選択肢もあります。世界水準の現場でキャリアをスタートできる可能性が広がります。

想定職種　プロセスエンジニア（製造工程スペシャリスト）

ASEでの主な業務（例）

- 製造工程の最適な計画立案
- 生産効率（歩留まり）の改善と分析
- 新しい製造技術の開発と新材料の導入

ADMISSION SCHEDULE

入学までのスケジュールと手続き

秋

出願期間

2026年9月15日～11月10日

出願締切を１１月１０日まで延長しました。
（引き続き若干名を募集しております。）

公式ウェブサイトよりオンラインで書類申請を実施。

秋

選考期間

2026年11月中旬～下旬

面接および書類審査を実施します。

冬

合否通知

2026年12月～2027年1月

入学許可および生活手当の正式な通知を発行。

春

渡航・入学

2027年2月

新学期開始。台湾での新生活とキャリアへの挑戦がスタート。

CONTACT

日本からのお問い合わせ先

銘傳大学　日本教育センター

メールアドレス

ihp@mail.mcu.edu.twまたはintl_ed@mail.mcu.edu.tw

Prof. Fu-Chien Chiu（邱福千 教授）
Ms. Wei-Mei Sun（孫瑋鎂 秘書）

電話番号

+886-3-3507001 （内線3704または5370）

所在地・受付

台湾 桃園市亀山区徳明路5号

世界を牽引する台湾の半導体産業で、あなたの未来を切り拓く。